

スルーホール用硫酸銅めっき添加剤

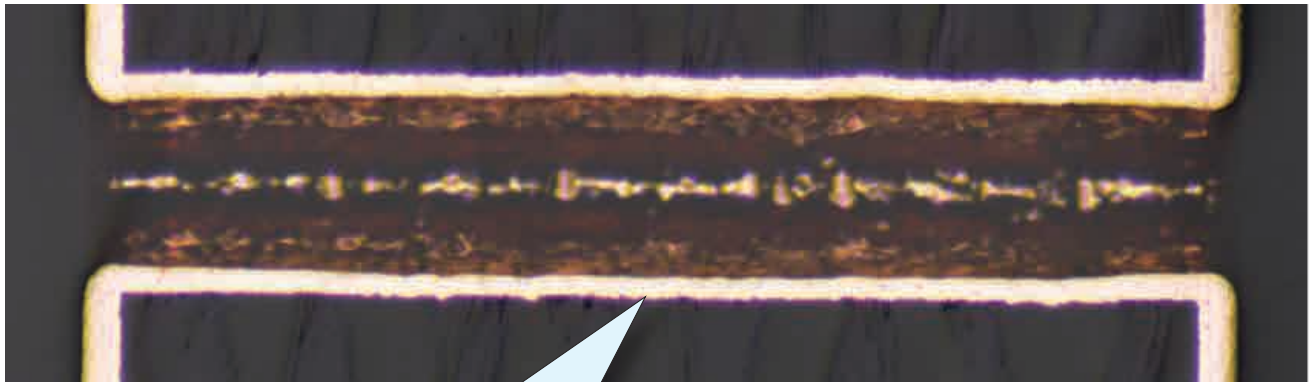
トッパールチナHT

Additives for Acid Copper Plating to Through-hole Plating

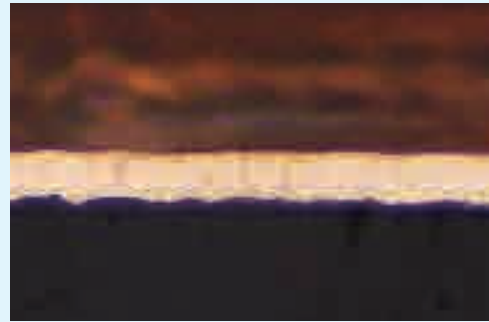
TOP LUCINA HT

- 幅広い電流密度で高いスローイングパワーが得られる
- 熱衝撃性に優れた高展延性の光沢皮膜が得られる
- 全ての添加剤成分の定量分析が可能

- Excellent throwing power in wide range of current density
- Superior ductility, excellent in thermal shock resistance and brightness
- Quantitative analysis is possible for all additives



トッパールチナHT
TOP LUCINA HT



従来浴
Conventional bath

硫酸銅五水和物 70g/L 硫酸 200g/L 塩化物イオン 50mg/L
電流密度 3A/dm² 穴径 0.3mm 板厚 1.6mm
CuSO₄·5H₂O 70g/L H₂SO₄ 200g/L Cl⁻ 50mg/L
Current density 3A/dm² Hole diameter 0.3mm Board thickness 1.6mm

